

Herstellung elektronischer Baugruppen, Assembling

Spezifikationen		
Elektronische Baugruppen	- Nutzenverarbeitung - maximale Größe - Fertigungslose	443 x 508 mm ab 1 Stück
THT	- alle Bauformen - Löten per Schwallötmaschine oder Hand	
SMD	- kleinste Bauform - BGA-Bestückung - Bestückung per Automat oder Hand - Dampfphasenlöten / Reflowlöten - Lötpasten- bzw. Kleberdruck mit Jet Print oder Pastenschablone	.0201
Materialbeschaffung	- Prüfung auf Verfügbarkeit auch bei Kleinstmengen - Einkauf weltweit (u.a. von abgekündigten und schwer beschaffbaren Bauteilen) - Verarbeitung von Kundenbeistellmaterial - mfangreiches Bauteilsortiment am Lager	
Besonderheiten	- Montage von Steckverbindern, Kühlkörpern (Schrauben, Nieten) - Frontplatten- und Gehäuseeinbau - Komplettierung und Verdrahtung - Baugruppenverguß / Printschutzlack	
Technische Beratung	- Dokumentationserstellung - Hilfe bei Bauteil Auswahl - Erstellung von CAD-Daten	
Qualitätskontrolle	- optische Kontrolle - AOI - elektrischer Test / Abgleich von Baugruppen - Inbetriebnahme nach Kundenwunsch - Erstmusterprüfung	
Daten	- ODB++ - Pick- & Place-Listen und Gerberdaten - Stücklisten, Bestückungspläne - Verarbeitung von Eagle, Target, Gerberdaten, KiCard - Musterplatinen	
Zertifikate / Normen	- ISO 9001:2015 - IPC-A-610 class I und II	

spezielle Ausführungen auf Anfrage